

2020年4月27日

IC パッケージ基板生産設備の能増更新及び次世代対応投資(第2期投資)

当社におきましては、サーバー、画像処理などを中心とした顧客需要に対応するため、IC パッケージ基板の生産能力増強を図る目的で、2018年11月に総額700億円の設備投資を決定、開示いたしました(第1期投資)。今回、更なる顧客需要に対応するため、下記のとおり追加で設備投資を実施することを決定いたしました。

今後、半導体市場は、5G・ICTの進展によるデータセンター市場の拡大や、車載用の画像解析など、企業活動を中心にデジタル化やクラウド化が加速し、高機能ICパッケージの更なる需要拡大と難仕様化が見込まれております。当社におきましては、中期経営計画の達成に向け、新たな需要に確実に対応することで、ICパッケージ基板市場における強固な地位を確立し、電子事業の安定した成長を目指していきます。

<設備投資の概要(予定)>

- (1) 投資内容：IC パッケージ基板生産設備の能増更新及び次世代対応投資(第2期投資)
- (2) 投資額：600億円(2020～2022年度合計、第1期投資と合わせた総額は1,300億円)
- (3) 設置場所：大垣中央事業場(第2棟)
- (4) 稼働時期：2020年度末より順次稼働開始し、2021年度より量産開始の計画



大垣中央事業場 全景

以上

【本件に関するお問合せ先】
経営企画部 経営企画グループ
担当：廣瀬・水谷
Tel: (0584)-81-7973